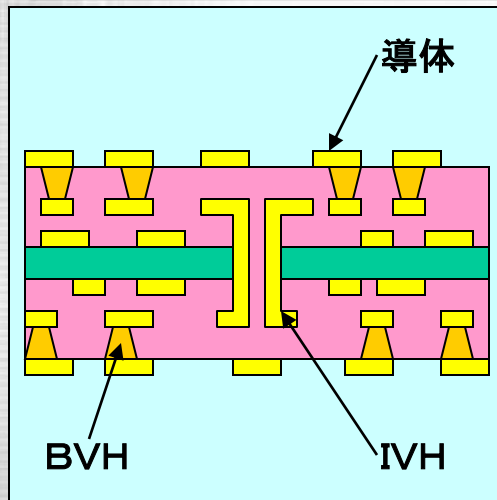


ビルドアップ

多層プリント配線板

1+4+1構造

ビルドアップ多層プリント配線板



■ダイレクトレーザー加工

VIA径 100~150 μ m
絶縁層厚 60~100 μ m
銅箔厚 5 μ m

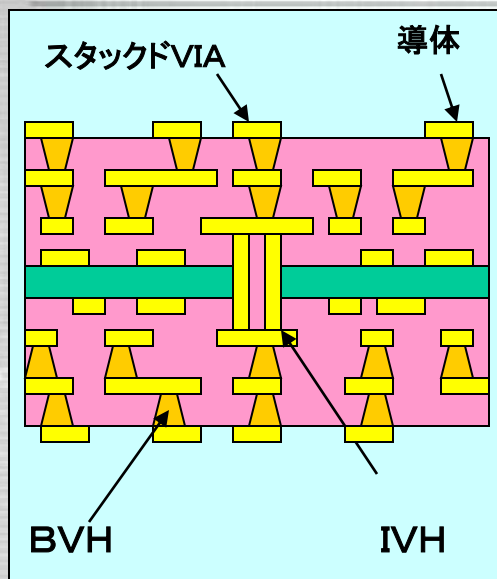
■VIAフィルメッキ加工

樹脂埋め工程無し

■パッドonVIAも可能

2+4+2構造

ビルドアップ多層プリント配線板



■2段ビルドアップ構造

■スタックドVIA仕様も可能

■多彩なバリエーション

■社内ネットワーク設計も可能

cgk

株式会社ちの技研

ISO9001
認証

ISO14001
認証

chimo-giken